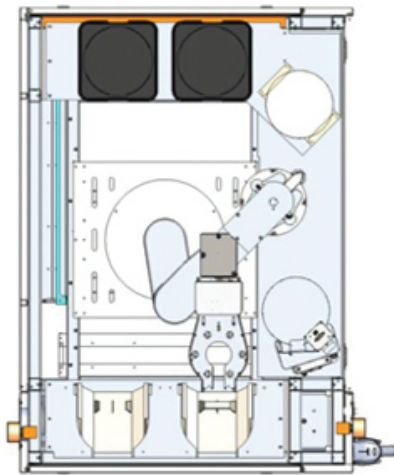


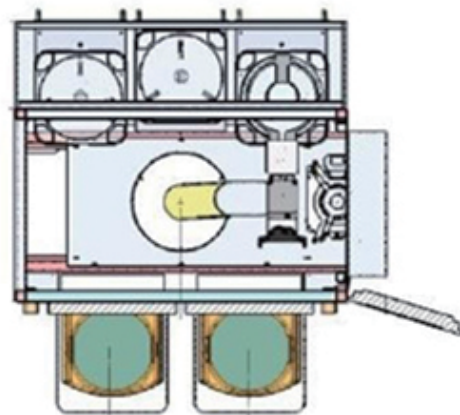
晶圓裝卸分類設備

Wafer Packing

系統自動偵測盒內晶圓距離，可安全地由晶圓 (50~1600 μ m 翹曲) 之正面進行取/放，系統可分辨多種隔離材質(Separator)，並偵測重疊之隔離紙以放於正確之位置。可依晶圓的位置或 ID 進行分類 (Sort:transfer/split/merge)。裝卸速度每小時 80 片，可升級到 120 片。符合 SEMI 之多種平臺及升級配備；僅需加購尺寸更換配件即可 6"，8"，12" 晶圓共用。符合 SECS/GEM 標準通訊機能；亦可加清洗站或目檢站或其他檢測設備 (例如顯微鏡)。



4" ~8" LAYOUT
(約 1370 x 990 x 2000mm)



12" LAYOUT
(約 1400 x 1050 x 2040mm)

特點

- Highly configurable platform
- Vortex "contactless" wafer handling
- Configurable for most containers types
- Common platform design for all wafer size compact footprint
- End-of-line configurability